国际先进封装产业化技术论坛

**暨**“**第**六**届华进开放日**”**活动参会报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称Unit |  |
| 地 址Address |  | 邮 编zip code | 　 |
| 经营范围Scope of business |  | 参会总人数 | 共 人 |
| 参会代表Name | 职务Title | 性别Gender | 联系手机Cellphone | 是否需要预定酒店Book hotel for you(Yes/No) | 入住日期Check-in Date | 退房日期Check-out Date |  是否参加 27日晚宴 (Yes/No) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **如有其它需求,请说明:**  |

**（注：本表复印有效，请完整填写后邮件给我们，谢谢！）**

**报名咨询热线：**

**华进半导体封装先导技术研发中心有限公司--战略研究与产业化部**

孙绪燕 Tel：151 6167 1816， 0510-6667 9351， Email：[xuyansun@ncap-cn.com](file:///C%3A%5CUsers%5Cchaoxu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CKTF3MD8P%5Cxuyansun%40ncap-cn.com)